## Исследование температурных эффектов в модели термического пика в высоко-ориентированном пиролитическом графите при облучении тяжелыми ионами <sup>86</sup>Kr и <sup>209</sup>Bi высоких энергий

И.В. Амирханов, Д.З. Музафаров, И.В. Пузынин, Т.П. Пузынина, Н.Р. Саркар, И. Сархадов, З.А. Шарипов

Лаборатория информационных технологий, ОИЯИ

А.Ю. Дидык

Лаборатория ядерных реакций, ОИЯИ

#### Abstract

The studies of temperature effects at anisotropic material - highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) under irradiation by  ${}^{86}Kr$  (253 MeV) and  ${}^{209}Bi$  (710 MeV) heavy ions in frames of three dimensional thermal spike model were carried out. The temperature effects versus the changes of electron-phonon interaction coefficients g are considered at this model. It has been shown that the surface temperature of HOPG target under irradiation by  $^{209}Bi$ ions can be higher than the melting temperature or evaporation temperature of HOPG if the value of electron-phonon interaction coefficients g satisfy inequality  $q > 1.5 \times q_k$ , where  $q_k =$  $3,12 \times 10^{12} Wt/(sm^3 K)$ . The surface temperature of HOPG under irradiation by 86Kr ions is less than the melting temperature if the value of electron-phonon interaction coefficients g satisfies inequality  $q \leq 4, 5 \times q_k$ . It is possible to conclude using the performed calculations and experimental data from surface structure studies of single crystal HOPG after irradiation by  ${}^{209}Bi(710 \text{ MeV})$  and  ${}^{86}Kr(253 \text{ MeV})$ , that the developed thermal spike model allows one to explain creation of the crater like structures after  $^{209}Bi$  ion irradiation and absence of such structures in the case of  ${}^{86}Kr$  ion irradiation. Such experimental data can take place if electron-phonon interaction coefficients g satisfy inequality  $1, 5 \times g_k \leq g \leq 4, 5 \times g_k$ . Estimations of maximum sizes of volume at HOPG under irradiation by bismuth ions where temperature can be higher the melting temperature are made.

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий большое внимание привлекают научно-исследовательские работы по изучению вопросов создания малоразмерных структур, обладающих уникальными свойствами, например, "квантовые точки" - гетероструктуры [1,2] с пространственным ограничением заряда по всем трем измерениям и другие наноструктуры. Такие исследования пользуются популярностью практически во всех центрах по физике твердого тела. Значительное развитие получили также работы, связанные с получением наноструктур в материалах при воздействии на них ускоренных тяжелых ионов различных энергий (см., например [3, 4]). Отметим, что до настоящего времени далеко не ясны механизмы взаимодействия тяжелых ускоренных ионов с твердыми телами [5,6], несмотря на достаточно продолжительное время, в течение которого такие работы проводятся (см., например [7,8] и цитированную там литературу). Существующие модели для объяснения наблюдаемых эффектов при воздействии ускоренных заряженных частиц на материалы, такие, как термический пик [9–14], кулоновский взрыв [15,16], двойной электрический слой, модель двухкомпонентной плазмы с холодными ионами и горячими электронами [17] или их комбинации даже для структур одного класса иногда не могут объяснить происходящие процессы. Одним из направлений в наноразмерных исследованиях и технологиях является создание структур на основе углерода, например, фуллеренов - структур, представляющих собой сферическое образование из 60 атомов углерода - С<sub>60</sub>, углеродные нанотрубки и другие. К углеродным структурам, представляющим значительный интерес, относится и высокоориентированный пиролитический графит (ВОПГ) [18].



Рис. 1: Схемы слоевой структуры ВОПГ: а – вид сбоку, б – вид сверху

Изучение этого объекта при воздействии на него тяжелых ионов может дать важную информацию о процессах взаимодействия таких частиц с сильно неоднородной структурой квазиодномерными монокристаллами ВОПГ. Схематическая структура ВОПГ представлена на рис.1. Видно, что параметры решетки вдоль плотноупакованных плоскостей и между плоскостями значительно различаются, вследствие чего теплопроводность ВОПГ отличается вдоль этих взаимно-перпендикулярных направлений до 300 раз. Интерес к таким задачам обусловлен проводящимися исследованиями в области радиационной физики конденсированных сред и направлен на изучение изменений свойств материалов при облучении и при высокодозной ионной имплантации в современных нанотехнологиях, а также важен для развития существующих моделей, описывающих взаимодействия заряженных частиц с материалами [19–27], и разработки эффективных численных схем и алгоритмов для решения уравнений математической физики, формулируемых при создании и модификации существующих моделей для решения вышеуказанных задач.

В работе [40] проведено численное исследование тепловых процессов в ВОПГ при облучении ионами висмута с энергией 710 МэВ и ионами криптона с энергией 253 МэВ в рамках модели термического пика [19, 23, 25, 28–31].

# 2. МОДЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ВОПГ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ

Для анизотропных материалов и с учетом аксиальной симметрии система уравнений для определения решеточной и электронной температур (модель термического пика) в цилиндрической системе координат в трехмерном случае может быть записана в виде [19,23, 25,28–31]:

$$C_e(T_e)\frac{\partial T_e}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\lambda_e^{\perp}(T_e)\frac{\partial T_e}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda_e^{\parallel}(T_e)\frac{\partial T_e}{\partial z}\right) - g(T_e)(T_e - T_i) + A(r, z, t), \quad (1)$$

$$C(T_i)\frac{\partial T_i}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\lambda_i^{\perp}(T_i)\frac{\partial T_i}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\lambda_i^{\parallel}(T_i)\frac{\partial T_i}{\partial z}\right) + g(T_e)(T_e - T_i).$$
(2)

Ось z направлена перпендикулярно облучаемой поверхности мишени, т.е. по направлению движения тяжелого иона. Производная по углу отсутствует ввиду цилиндрической симметрии удельных ионизационных потерь тяжелого иона. Здесь  $T_e(r, z, t)$  и  $T_i(r, z, t)$ -температуры в электронной и решеточной подсистемах,  $C_e(T_e)$ ,  $C_i(T_i)$  и  $\lambda_e(T_e)$ ,  $\lambda_i^{\parallel,\perp}(T_i)$  – соответственно удельные теплоемкости и удельные теплопроводности электронов и решет-



Рис. 2: Зависимость удельных ионизационных потерь энергии ионов висмута  $^{209}{\rm Bi}$  с энергией 710 МэВ (a) и ионов криптона  $^{86}{\rm Kr}$  с энергией 253 МэВ (б) от глубины в ВОПГ

ки, соответственно, в общем случае зависящие от температуры. В данной работе значения этих теплофизических параметров выбираются равными их значениям при комнатной температуре. Символы «||» и « $\perp$ » означают, что теплопроводность зависит от направления, и соответствуют направлениям в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, а именно: вдоль и перпендикулярно к поверхности.  $g(T_e)$  - коэффициент, характеризующий взаимодействия электронной подсистемы с решеткой (в общем случае зависящий от температуры электронного газа). Функция - A(r, z, t) объемная плотность вносимой ионом мощности. Она может быть представлена в виде наиболее часто используемого выражения, введенного в работах [32, 33]:

$$A(r,z,t) = bS_{inel0} \exp\left(-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma_t^2}\right) \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) \mu(z).$$

где  $t_0 \simeq (1-5) \cdot 10^{15}$ с время достижения равновесного распределения электронов, т.е. время свободного пробега  $\delta$ -электронов со средней энергией  $\varepsilon_e$ . Полуширина распределения по времени принята равной  $\sigma_t = t_0$  [25]. Скорость экспоненциального спада, или пространственная ширина возбужденной области -  $r_0 \leq 2,5$  нм [32] или  $r_0 \simeq 1$ нм [33].  $S_{inel}(z)$ зависимость удельных ионизационных потерь энергии ионов от глубины в мишени. Она рассчитана по наиболее часто используемой компьютерной программе SRIM-2003 и приведена ниже для ионов висмута (рис.2.а) и для ионов криптона (рис.2.б).

Нормирующий множитель b определяется из условия нормировки:

$$\int_{0}^{\infty} dt \int_{0}^{r_m} 2\pi r A(r,z,t) dr = S_{inel}(z);$$

начальные условия запишем в следующем виде:

$$T_{e,i}(r,z,0) = T_0 = 300 \ K,\tag{3}$$

а граничные условия могут быть представлены как:

$$\frac{\partial T_{e,i}(r,z,t)}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial T_{e,i}(r,z,t)}{\partial z}\Big|_{z=0} = 0,$$

$$T_{e,i}(R_{\max},z,t) = T_{e,i}(r,Z_{\max},t) = T_0.$$
(4)

В (4)  $R_{\text{max}}$  – радиус удаления от траектории иона, а  $Z_{\text{max}}$  глубина, превышающая длину проективного пробега иона, при которых решетку можно считать невозмущенной, а ее температуру при  $r > R_{\text{max}}$  и  $z > Z_{\text{max}}$  равной  $T_0$ . Тем самым начальные и граничные условия означают, что в начальный момент времени электронная и ионная подсистемы имеют

Теплоемкость электронного газа	$C_e(T_0) = 3,73 \times 10^{-2} \ \mathrm{Дж}/(\mathrm{см}^3 \ \mathrm{K})$
Теплопроводность электронного газа	$\lambda_e^\perp(T_0)=5,6\;\mathrm{Bt/(cm\;K)}$
	$\lambda_e^\parallel(T_0)=5,6 imes 10^{-3}~{ m Bt}/({ m cm~K})$
Теплоемкость кристаллической решетки	$C_i(T_0) = 3,73  imes 10^{-2} \ { m Дж}/({ m cm}^3 \ { m K})$
Теплопроводность кристаллической решетки	$\lambda_i^\perp(T_0)=20\;\mathrm{Bt}/(\mathrm{cm\;K})$
	$\lambda_i^{\parallel}(T_0)=5,7 imes 10^{-2}~{ m Bt}/({ m cm~K})$
Энергетические потери при входе в ВОПГ	$S^{Bi}_{inel}(T_0) = 4,4  imes 10^{-8} \; { m Дж/cm}$
для ионов висмута с энергией 710 МэВ	
Энергетические потери при входе в ВОПГ	$S^{Bi}_{inel}(T_0) = 1,84  imes 10^{-8}$ Дж/см
для ионов криптона с энергией 253 МэВ	

Таблица 1: Параметры ВОПГ и энергетические потери ионов на входе в мишень

температуру, равную комнатной, а граница z = 0 теплоизолирована. Кроме того, температуры электронного газа и решетки на большом расстоянии от траектории иона также равны комнатной температуре.

Физические параметры системы для кристаллической решетки ВОПГ (рис.1.) при комнатной температуре [18,34–36] приведены в Таблице 1.

В работах [19,23] было предложено следующее выражение для вычисления коэффициента электрон-фононного взаимодействия *g*:

$$g = \frac{\pi^2 m_e S^2 n}{6\tau_0 T_D},$$

где  $T_D$  – температура Дебая,  $\tau_0$  – время свободного пробега электронов при  $T = T_D$ , S – скорость звука, n – число свободных электронов в единице объема,  $m_e$  – масса электрона. Или в следующем виде:

$$g = \frac{\pi^4 (k_B n S)^2}{18\lambda_e(T_e)}$$

где  $\lambda_e(T_e)$  – теплопроводность электронного газа,  $k_B$  – постоянная Больцмана. Из последней формулы видно, что коэффициент взаимодействия g зависит от теплопроводности электронного газа, т.е также зависит от направления. При подстановке значений  $\lambda_e^{\perp}(T_e)$  и  $\lambda_e^{\parallel}(T_e)$  в последнюю формулу получим следующие значения:

 $g(\lambda_e^{\perp})=3,12 imes 10^{12}~{
m Bt}/({
m cm}^3~{
m K})$  и  $g(\lambda_e^{\parallel})=3,12 imes 10^{15}~{
m Bt}/({
m cm}^3~{
m K})$ 

Так как этот параметрgзависит от направления, задачу будем решать при различных значениях параметра g в отрезке  $g(\lambda_e^{\perp}) \leq g \leq g(\lambda_e^{\parallel}).$ 

### 3. МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ

Для численного решения системы (1) - (4) будем использовать явную двухслойную конечно-разностную схему порядка аппроксимации  $O(h_r^2 + h_z^2 + h_t)$  [37–39]. Для проверки сходимости разностных схем проводился численный анализ решений при фиксированных шагах  $h_r, h_t$  и на сгущающейся сетке по z, т.е.  $h_z, h_z/2, h_z/4$ . Ниже представлены результаты анализа в точке r = 0, z = 0:

$$\begin{split} & \max_{\substack{0 \le t \le 0,3}} |T^e_{h_z}(0,0,t) - T^e_{h_z/2}(0,0,t)| = 8,3 \times 10^{-4}, \text{ при } t = 0,075 \\ & \max_{\substack{0 \le t \le 0,3}} |T^e_{h_z/2}(0,0,t) - T^e_{h_z/4}(0,0,t)| = 3,17 \times 10^{-4}, \text{ при } t = 0,074 \\ & \max_{\substack{0 \le t \le 0,3}} |T^i_{h_z}(0,0,t) - T^i_{h_z/2}(0,0,t)| = 6,32 \times 10^{-5}, \text{ при } t = 0,029 \end{split}$$



Рис. 3: Временные зависимости температуры кристаллической решетки на поверхности пирографита при облучении ионами висмута и криптона при разных значениях коэффициента взаимодействия (для висмута:  $1 - g_k = 3, 12 \times 10^{12} \text{Br}/(\text{см}^3 \text{ K}), 2 - g = 1, 25 \times g_k, 3 - g = 1, 5 \times g_k, 4 - g = 2 \times g_k;$  для криптона:  $1 - g_k = 3, 12 \times 10^{12}, 2 - g = 2 \times g_k, 3 - g = 4, 5 \times g_k, 4 - g = 7 \times g_k;$  штрихованной линией обозначена температура плавления ВОПГ). На рис.3 и ниже "С" обозначает ВОПГ (carbon)

$$\max_{0 \le t \le 0,3} |T^i_{h_z/2}(0,0,t) - T^i_{h_z/4}(0,0,t)| = 2, 1 \times 10^{-5}, \text{ при } t = 0,029$$

Как видно, найденные разности профилей температур на сгущающейся сетке уменьшаются, что свидетельствует об устойчивости схемы вычислений. Дальнейшие вычисления проводились при значениях шагов:  $h_r = 5 \times 10^{-3}$ ,  $h_z = 3 \times 10^{-3}$ ,  $h_t = 3 \times 10^{-6}$ .

#### 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Решая системы уравнений (1) - (4) были проанализированы временные и координатные зависимости температур электронного газа  $T_e(r, z, t)$  и решетки  $T_i(r, z, t)$  ВОПГ при облучении ионами висмута и ионами криптона.

На рис.3. представлены зависимости от времени температур решетки на поверхности ВОПГ при облучении ионами висмута и ионами криптона при разных значениях коэффициента электрон-фононного взаимодействия g. Из этих рисунков видно, что, начиная со значения параметра  $g \approx 1,5 \times g_k$  ( $g_k = 3,12 \times 10^{12}$  Вт/(см<sup>3</sup> K)), температура на поверхности ВОПГ при облучении ионами висмута может превышать температуру плавления. Этот же процесс при облучении ВОПГ ионами криптона начинается с существенно большего значения константы  $g \approx 4,5 \times g_k$ .

Основные экспериментальные данные при облучении ВОПГ ионами висмута и криптона следующие [31,34,35]:

А) При облучении ионами висмута вблизи поверхности ВОПГ (ионизационные потери энергии  $S_{inel}^{Bi}(z \propto 0) = 27,6$  кэВ/нм) методами сканирующей туннельной микроскопии были обнаружены структурные изменения, представляющие собой кратеры с глубиной более  $H_{cr} > 1$ нм и диаметром на поверхности  $D_{cr} \approx 5 - 7$  нм, поверхностная плотность которых примерно на порядок меньше плотности облучения ионами висмута [31, 34, 35]. Такие структуры, по-видимому, обусловлены термофлуктуационными эффектами при потерях энергии ионов висмута на ионизацию на входе в мишень ВОПГ. Это свидетельствует о том, что эти потери энергии сравнимы с пороговыми значениями ионизационных потерь энергии ( $S_{inel}^{Bi}(z = 0) \propto S_{inel}^{Threshold}$ ) для возникновения перегретой области вблизи поверхности с температурой выше температур плавления ( $T_i^{Bi}(z \propto 0) \ge T_{melt,C}$  при значении константы  $g \ge 1, 5 \times g_k$  (см. рис.3а - кривая 3)) или даже испарения ( $T_i^{Bi}(z \propto 0) \ge T_{subl,C}$ ) ВОПГ. То есть обнаруженые структуры (кратеры) могут быть объяснены в рамках модели термического пика, за



Рис. 4: Зависимость максимального радиуса области, где температура превышает температуру плавления ВОПГ, от значений параметра *g* при облучении ионами висмута и криптона

счет резкого увеличения коэффициентов испарения атомов графита с поверхности в области трека иона висмута с высокими температурами вблизи поверхности.

Б) При облучении ионами криптона подобных структурных изменений на поверхности ВОПГ обнаружено не было. Отметим, что ионизационные потери энергии ионов криптона вблизи поверхности более, чем в два раза меньше, чем для ионов висмута  $(S_{inel}^{Kr}(z \propto 0) = 12 \text{ кэВ/нм})$ . Поэтому при облучении ионами криптона, по-видимому,  $(S_{inel}^{Kr}(z=0) < S_{inel}^{Threshold})$  и соответственно  $T_i^{Kr}(z \propto 0) < T_{melt,C}$ .

Исходя из результатов, представленных на рис.3 для ВОПГ, облученного ионами криптона ( $T_i^{Kr}(z \propto 0) < T_{melt,C}$ , (см. рис.36 - кривая 3)) и висмута ( $T_i^{Bi}(z \propto 0) \geq T_{melt,C}$ ) константа электрон-фононного взаимодействия должна удовлетворять двойному неравенству: 1,5 ×  $g_k \leq g \leq 4,5 \times g_k$ .

На рис.4. представлена зависимость максимального радиуса области, где температура решетки может превышать температуру плавления ВОПГ, от значений константы электронфононного взаимодействия g при облучении ВОПГ ионами висмута и криптона. Из этих рисунков видно, что при увеличении g размер максимальной области сначала быстро растет, но постепенно стабилизируется и выходит на насыщение.

Это свидетельствует о том, что, начиная с некоторого значения параметра g, максимальный диаметр "расплавленной" области или, что более точно, области, нагретой до температуры выше температуры плавления, не будет расти, т.е представленная модель не противоречива и адекватно описывает явления при прохождении высоко-ионизирующих ионов через квазиодномерную структуру ВОПГ. В дальнейших представленных рисунках значение параметра g взято в виде  $g = 2 \times g_k$ .

На рис.5. и рис.6. представлены зависимости от времени температуры электронного газа и решетки на поверхности ВОПГ при облучении ионами висмута и ионами криптона для разных расстояниях от оси ОZ. Из этих рисунков видно, что при облучении висмутом, начиная со времени  $t = 0,062 \times 10^{-13}c$ , температура превышает температуру плавления пирографита, а при облучении криптоном температура мишени не доходит до температуры плавления пирографита.

На рис.7. представлена временная динамика изменений изотермической поверхности - поверхности, где температура равна температуре плавлении ВОПГ при облучении ионами висмута.

### 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе на основе линейной двухтемпературной модели термического пика получены



Рис. 5: Временная зависимость температур электронного газа и кристаллической решетки на поверхности ВОПГ при облучении ионами висмута от расстояний до оси трека иона при значениях: 1 - r = 0Å; 2 - r = 20Å; 3 - r = 40Å. Штрихованной линией обозначена температура плавления ВОПГ



Рис. 6: Временные зависимости температур электронного газа и кристаллической решетки на поверхности ВОПГ, при облучении ионами криптона от расстояний до оси трека при значениях: 1 - r = 0Å; 2 - r = 20Å; 3 - r = 40Å

результаты численного анализа температур электронного газа и кристаллической решетки при облучении монокристаллического высоко-ориентированного пиролитического графита ионами висмута с энергией 710 МэВ и ионами криптона с энергией 253 МэВ. Выполнен анализ точности схемы вычислений и показано, что схема устойчива. Проведены исследования температурных эффектов в модели в зависимости от коэффициента электрон-фононного взаимодействия *g*:

1. Показано, что в случае облучения ВОПГ ионами висмута с энергией 710 МэВ температура на поверхности мишени может превышать температуру плавления и даже температуру испарения-возгонки при значениях константы электрон-фононного взаимодействия  $g \ge g_3 = 1,5 \times g_k$ , где  $g_k = 3,12 \times 10^{12}$  Вт/(см<sup>3</sup>K) (см.рис.3а).

2. При облучения ВОПГ и<br/>онами криптона с энергией 253 МэВ температура на поверхности мишени не превышает температуру плавления при значениях коэффициента электронфононного взаимодействия <br/>  $g \leq g_3 = 4, 5 \times g_k$  (см. рис.36).

3. Исходя из экспериментальных данных по изучению изменений структуры поверхности монокристалла ВОПГ, облученного ионами висмута с энергией 710 МэВ и криптона с



Рис. 7: Динамика движения изотермической поверхности, то есть поверхности, где температура равна температуре плавления ВОПГ, при облучении ионами висмута на временном интервале  $\Delta t = 6,0 \times 10^{-15} \div 8,4 \times 10^{-15}$  с (размеры цилиндра: диаметр – D = 100Å при глубине –  $Z = 2,1 \times 10^5$ Å)

энергией 253 МэВ [27, 34, 35], на основании расчетов можно сделать вывод, что для объяснения наличия структур типа кратеров (с глубиной более  $H_{cr} > 1$  нм и диаметром на поверхности  $D_{cr} \approx 5 - 7$  нм) на поверхности ВОПГ при облучении ионами висмута и их отсутствия в случае облучения ионами криптона, можно использовать развитую в данной работе модель термического пика, которая позволяет объяснить данные отличия при значениях коэффициента электрон-фононного взаимодействия, удовлетворяющих двойному неравенству:  $1, 5 \times g_k \leq g \leq 4, 5 \times g_k$ .

Максимальный размер области в ВОПГ при облучении ионами висмута, в которой температура вблизи поверхности превышает температуру плавления, равен  $D_{max}^{melt} \simeq 60$ Å;  $Z_{max}^{melt} \simeq 203 \times 10^3$ Å ( $D_{max}^{melt}$  – оценка максимального диаметра и  $Z_{max}^{melt}$  – оценка максимальной глубины, где может происходить плавление). Расчетные данные получены при значении коэффициента электрон-фононного взаимодействия  $g \approx 2, 0 \times g_k = 6, 24 \times 10^{12}$  BT/(см<sup>3</sup>K).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты №06-01-00228 и №05-01-00645-а.

## Список литературы

- Zh.I.Alferov. Proc. of Nobel Symposium 99, Arild, Sweden, June 4-8, 1996; Physica Scripta 68, 32 (1996); Ж.И.Алферов. ФТП, 32 1 (1998).
- [2] Ж.И.Алферов и др. ФТП, т.32, № 4, с.385-410.
- [3] В.М.Михушкин, С.Е.Сысоев, Ю.С.Гордеев. Изв. АН РАН, сер.физическая, 2002, т.66, № 4, с.588-592.
- [4] S.Bouneau et al. Phys.Rev.B (in press).
- [5] D.Fink, L.Chadderton. Rad.Effects Defects in Solids, v.160, Nos 3-4, 2005, pp.67-83.
- [6] Ю.В.Мартыненко. ВИНИТИ, Итоги науки и техники. Пучки заряженных частиц, Москва, 1993, с.82-113.
- [7] Ф.Ф.Комаров. УФН, т.173, № 12, с.1287-1318.
- [8] Г.А.Блейхер, В.П.Кривобоков, О.В.Пащенко. Тепломассоперенос в твердом теле под действием мощных пучков заряженных частиц. Новосибирск, "Наука Сибирская издательская фирма РАН, 1999, 176 с.
- [9] F.Seitz, J.S.Koehler. Sol. St. Phys., 1956, v.2, p.251.
- [10] И.М.Лифшиц. ДАН СССР. 1956, т.109, № 6, с.1109-1111.
- [11] И.М.Лифшиц, М.И.Каганов, Л.В.Танатаров. Атомная энергия. 1959, т.6, с.391-402.
- [12] М.И.Каганов, И.М.Лифшиц, Л.В.Танатаров. ЖЭТФ. 1956, т.31, № 2(8), с.232-237.

- [13] Я.Е.Гегузин, М.И.Каганов, И.М.Лифшиц. ФТТ. 1973, т.15, № 8, с.2425-2428.
- [14] А.А.Давыдов, А.И.Калиниченко. Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Москва, 1985, вып.3(36), с.27-30.
- [15] R.L.Fleisher, P.B.Price, R.M.Walker. J. Appl. Phys. 1965, v.36, №11, p.3645-3652.
- [16] R.L.Fleisher, P.B.Price, R.M.Walker. Nuclear Track in Solids. Los Angelos: University of California. 1975.
- [17] И.А.Баранов, Ю.В.Мартыненко, С.О.Цепелевич, Ю.Н.Явлинский. УФН. 1988, т.156, №3, с.477-510.
- [18] А.С.Фиалков. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. Москва, Аспект пресс, 1997, 505 с.
- [19] Z.G.Wang, Ch.Dufour, E.Paumier et al. J. Phys.: Condensed. Matter. 1994, v.6, №34, p.6733-6750.
- [20] M.Toulemonde. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 1999, v.156, №1-4, p.1-11.
- [21] R.Neumann. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. 1999, v.151, №1-4, p.42-55.
- [22] S.Furuno, H.Otsu, K.Hojou et al. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. 1996, v.107, №1-4, p.223-226.
- [23] Ch.Dufour, A.Audouard, F.Beuneu et al. J. Phys.: Condens. Matter. 1993, v.5, №26, pp.4573-4584.
- [24] Audouard, E.Balanzat, J.C.Jousset et al. J. Phys: Condens. Matter. 1993, v.5, №5, pp.995-1018.
- [25] Ch.Dufour, E.Paumier, M.Toulemonde. Radiat. Eff. and Defects in Solids. 1993, v.126, p.119.
- [26] S.A.Karamian, Yu.Ts.Oganessian, V.N.Bugrov. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. 1989, v.43, №2, p.153-158.
- [27] А.Ю.Дидык. Известия РАН. Металлы. 1995, №3, с.128-135.
- [28] И.В.Амирханов и др. Письма в ЭЧАЯ, т.3, № 1(130), 2006, с.63-75.
- [29] И.В.Амирханов и др. Письма в ЭЧАЯ, т.3, № 5(134), 2006, с.80-91.
- [30] I.V.Amirkhanov et al. Crystallography Report, No 51, Suppl.1, 2006, pp.S32-S43.
- [31] И.В.Амирханов и др. Физика элементарных частиц и атомного ядра (ЭЧАЯ), 2006, т.37, вып.6, с.1592-1644.
- [32] M.R.P.Waligorski, R.N.Hamm, R.Katz. Nucl. Tracks and Radiat. Meas. 1986, v.11, pp.306-319.
- [33] I.S.Bitensky, P.Dimirev, B.U.R.Sundqust. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. 1998, v.82, pp.356-361.
- [34] А.Ю.Дидык и др. Письма в ЖТФ, 2000, т.26, №17, с.1-5.
- [35] Yu.N.Cheblukov et al. Journal of Advanced Materials, 2001, №5, p.42-45.
- [36] Физические величины. Справочник. Под. ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлиховой. М.: Энергоатомиздат, 1991.
- [37] А.А.Самарский. Теория разностных схем. М.: Наука, 1983, с.258-276.
- [38] А.А.Самарский, А.В.Гулин. Устойчивость разностных схем. М.: Наука, 1973, с.308-338.
- [39] Л.И.Турчак. Основы численных методов. М.: Наука, 1987, с.277-284.
- [40] И.В.Амирханов и др., Препринт ОИЯИ, Р11-2007-106.